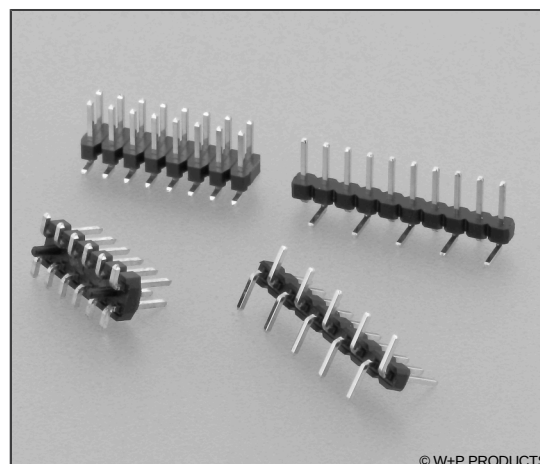


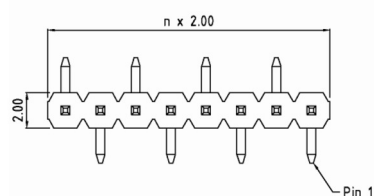
Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper	Thermoplast, nach UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Kontaktmaterial	Vierkantstift 0,50mm, Kupferlegierung
Contact Material	0.50mm square pin, copper alloy
Kontaktoberfläche	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni
Contact Surface	Acc. to options (see below), over Ni
Durchgangswiderstand	< 20 mΩ
Contact Resistance	< 20 mΩ
Isolationswiderstand	> 1000 MΩ
Insulation Resistance	> 1000 MΩ
Spannungsfestigkeit	1 kV DC
Test Voltage	1 kV DC
Nennspannung	250 V AC
Voltage Rating	250 V AC
Nennstrom	1 A
Current Rating	1 A
Temperaturbereich	-40 °C ... +125 °C
Temperature Range	-40 °C ... +125 °C
Verarbeitung	Reflow-Lötverfahren
Processing	Reflow soldering

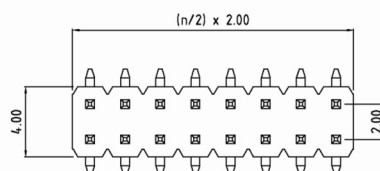


© W+P PRODUCTS

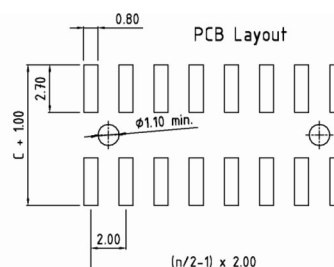
Passende Buchsenleisten:
 Compatible Female Headers:
7450 7451 4160 6192 etc.
 Weitere siehe Kapitel B
 Please see ch. B for more



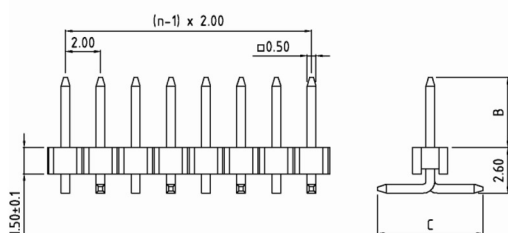
Single Row Layout B1



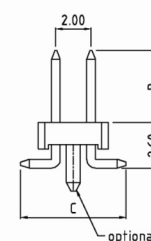
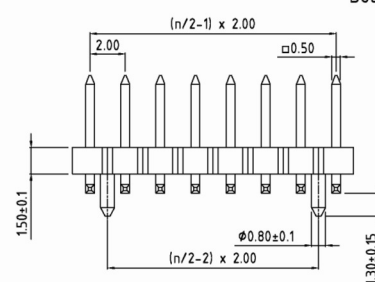
Double Row



PCB Layout

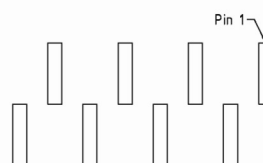
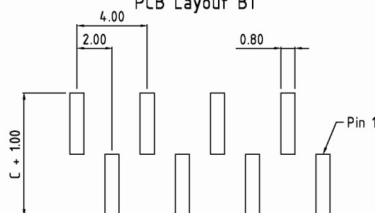


Single Row Layout B2



PCB Layout B1

PCB Layout B2



Series	Contacts*	Rows*	Dimensions*	Plating*	Locating Pegs*	Packaging*
7351	40	11	10	50	00	PPST
	03-40 Einreihig Single row	11 Einreihig B1 Single row B1	10 B=4,00 C=7,00mm	00 Vergoldet Gold plated	00 Ohne Pos.hilfen W/o loc. pegs	ST
	04-80 Zweireihig Double row	12 Einreihig B2 Single row B2	20 B=4,00 C=6,00mm	50 Verzinkt Tin plated	10 Mit Pos.hilfen (nur 2-reihig)	PPST
		20 Zweireihig Double row	99- Kundenspezifisch Customer-specific	60 Sel. Au/Sn Duplex plating	With loc. pegs (double row only)	PPTR (Option)

Lieferformen / Packaging Options:

ST In Stangen ohne Pick&Place-Pads / In tubes w/o Pick&Place-Pads

PPST In Stangen mit P&P-Pads / In tubes with P&P-Pads

PPTR (Option) Tape & Reel mit P&P-Pads / Tape & Reel with P&P-Pads

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
 bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
 * This is an **order example** -
 please replace by your specifications.

Informationen zum Reflow-Lötverfahren

Reflow Soldering Information

Reflow-Lötempfehlung für kurze Lötzeiten

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum T_{Smin}	150 °C
Temperatur Maximum T_{Smax}	200 °C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Temperatur Lötbereich T_L	217 °C
Verweildauer oberhalb T_L	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Höchsttemperatur T_P	260±5 °C
Dauer Höchsttemperatur	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Dauer 25 °C – Höchsttemperatur T_P	max. 8m

Reflow Soldering Recommendation For Shorter Peak Times

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature T_{Smin}	150 °C
Maximum Temperatur T_{Smax}	200 °C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Soldering Range Temperature T_L	217 °C
Duration above T_L	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Peak Temperature T_P	260±5 °C
Duration Peak Temperature	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Duration 25°C - Peak Temp. T_P	max. 8min

